

九州半導体人材育成等コンソーシアム (第4回会合)

～ 事務局報告 ～
2023年度の主な取組について（中間報告）

2024年2月27日
＜ 共同事務局 ＞
経済産業省 九州経済産業局
(一社) 九州半導体・デジタルイノベーション協議会

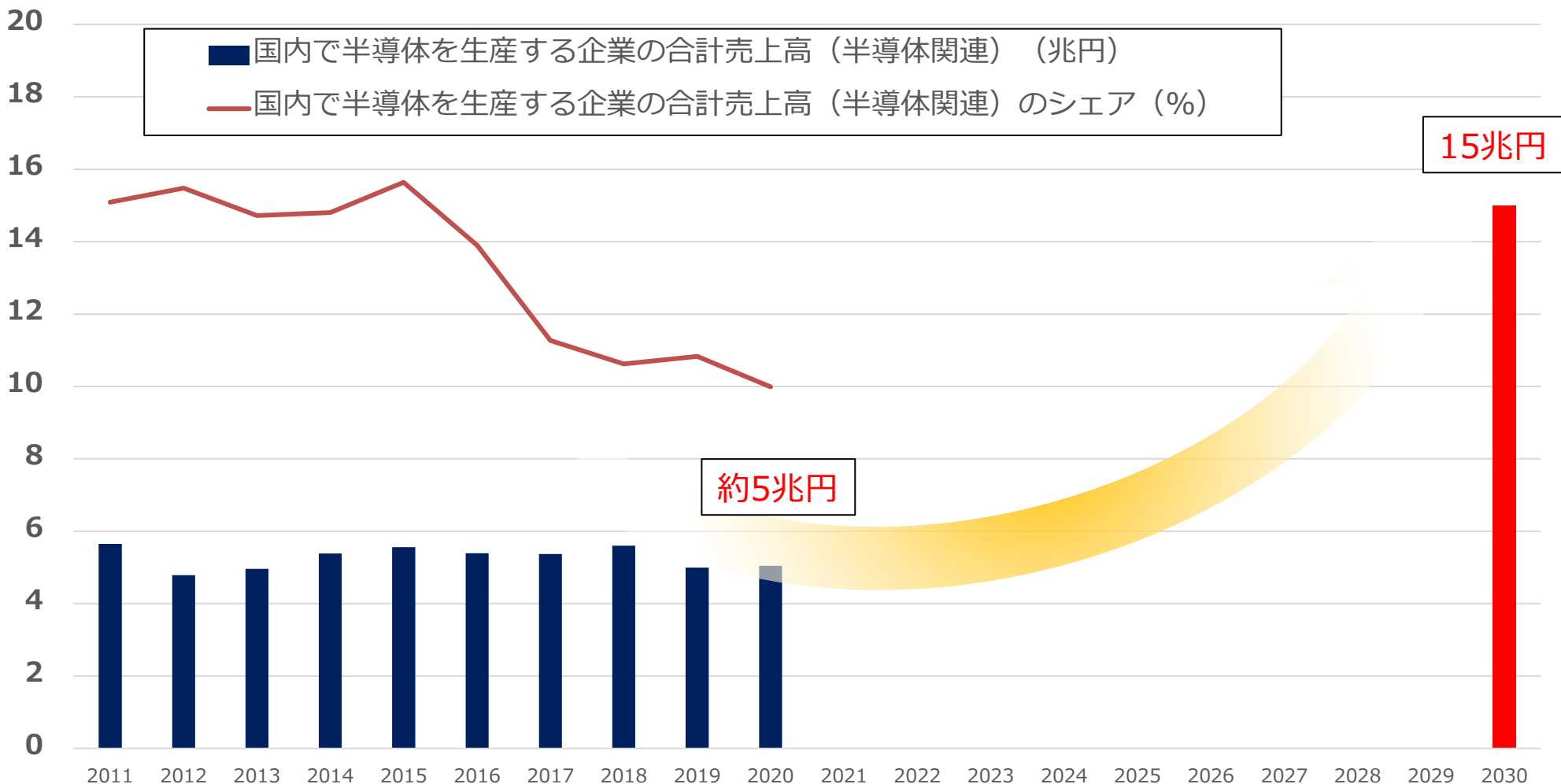


1. 九州の現状／全国の動向

半導体・デジタル産業戦略 ～ 売上高の増加目標 ～

- 2030 年に、国内で半導体を生産する企業の合計売上高（半導体関連）として、15 兆円超を実現し、我が国の半導体の安定的な供給を確保する。

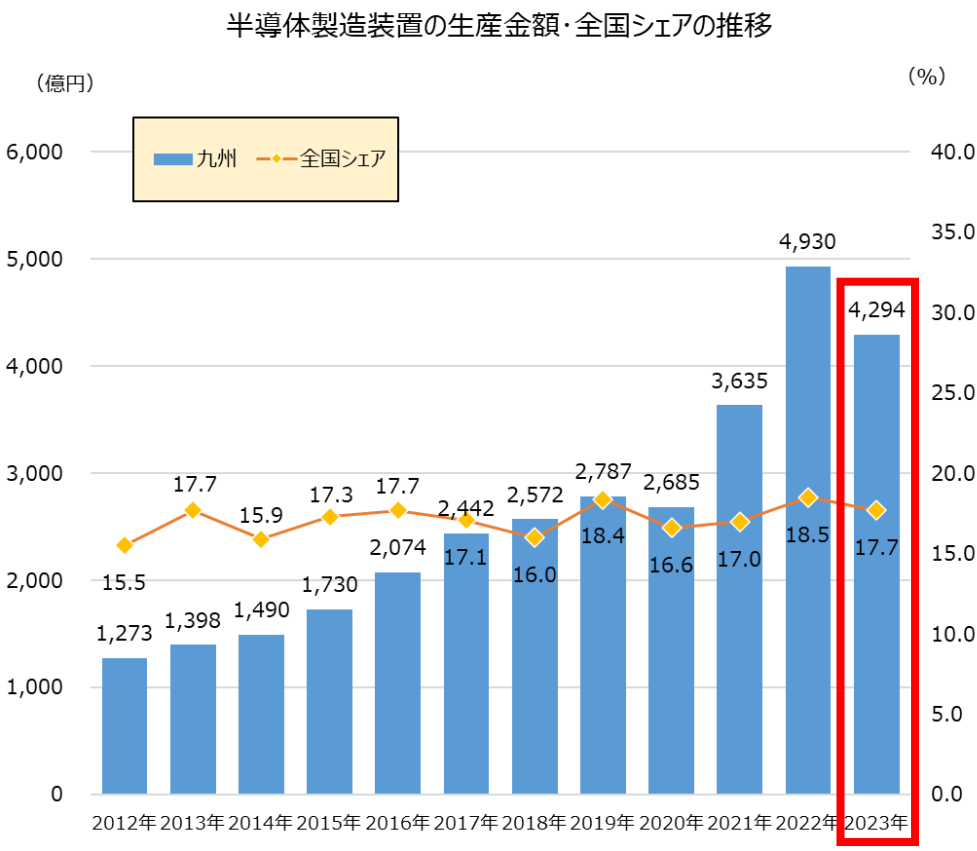
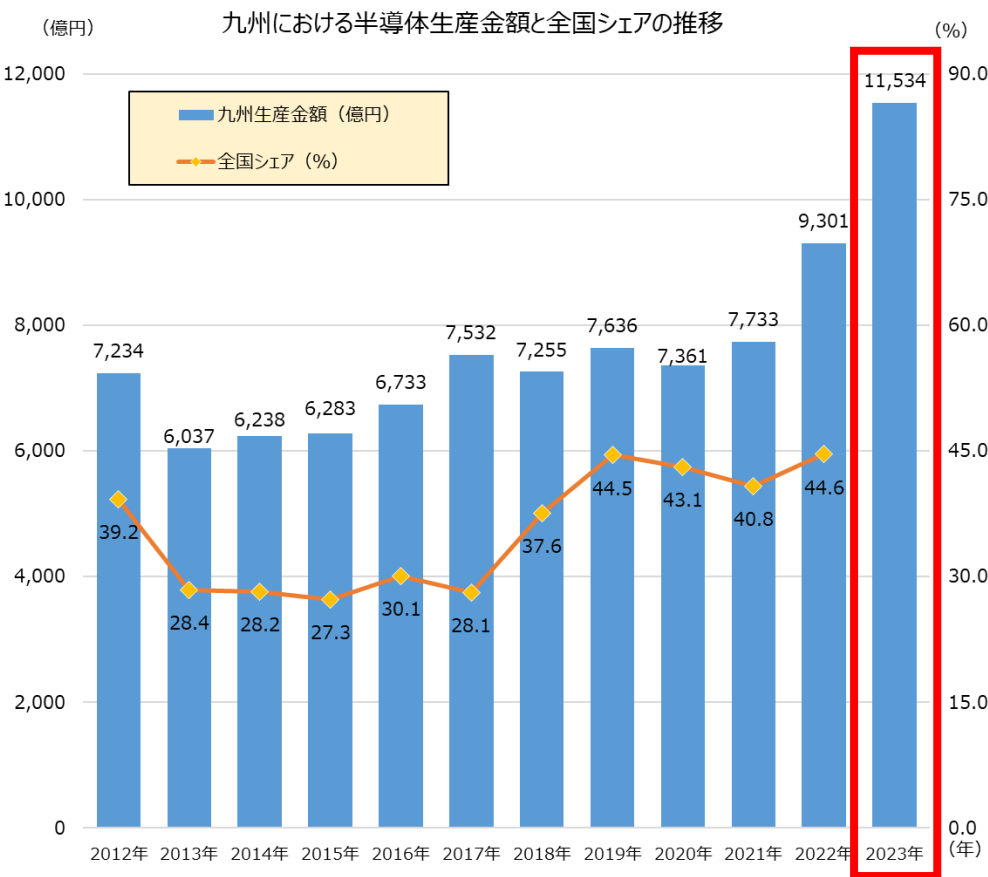
(% / 兆円)



（出典）実績分について、世界全体の売上はOMDIA、日本国内売上は経済産業省「工業統計調査」の品目別出荷額の値を集計。出荷額については、半導体関連（半導体素子、光電変換素子、集積回路）及び、「他に分類されない電子部品・デバイス・電子回路」のうち半導体関連品目を出荷額ベースで按分した値の合計。

九州の半導体/製造装置の生産の推移

- 九州のIC生産実績は、高付加価値品などを中心に高水準での生産が続き、2023年の生産金額は1兆1,534億円となり、16年ぶりに1兆円を上回った（過去5番目）。
- 九州の半導体製造装置の生産金額については、過去最高だった2022年を下回ったものの、堅調な需要に支えられ、2023年の生産金額は4,294億円で引き続き高水準を維持した（過去2番目）。

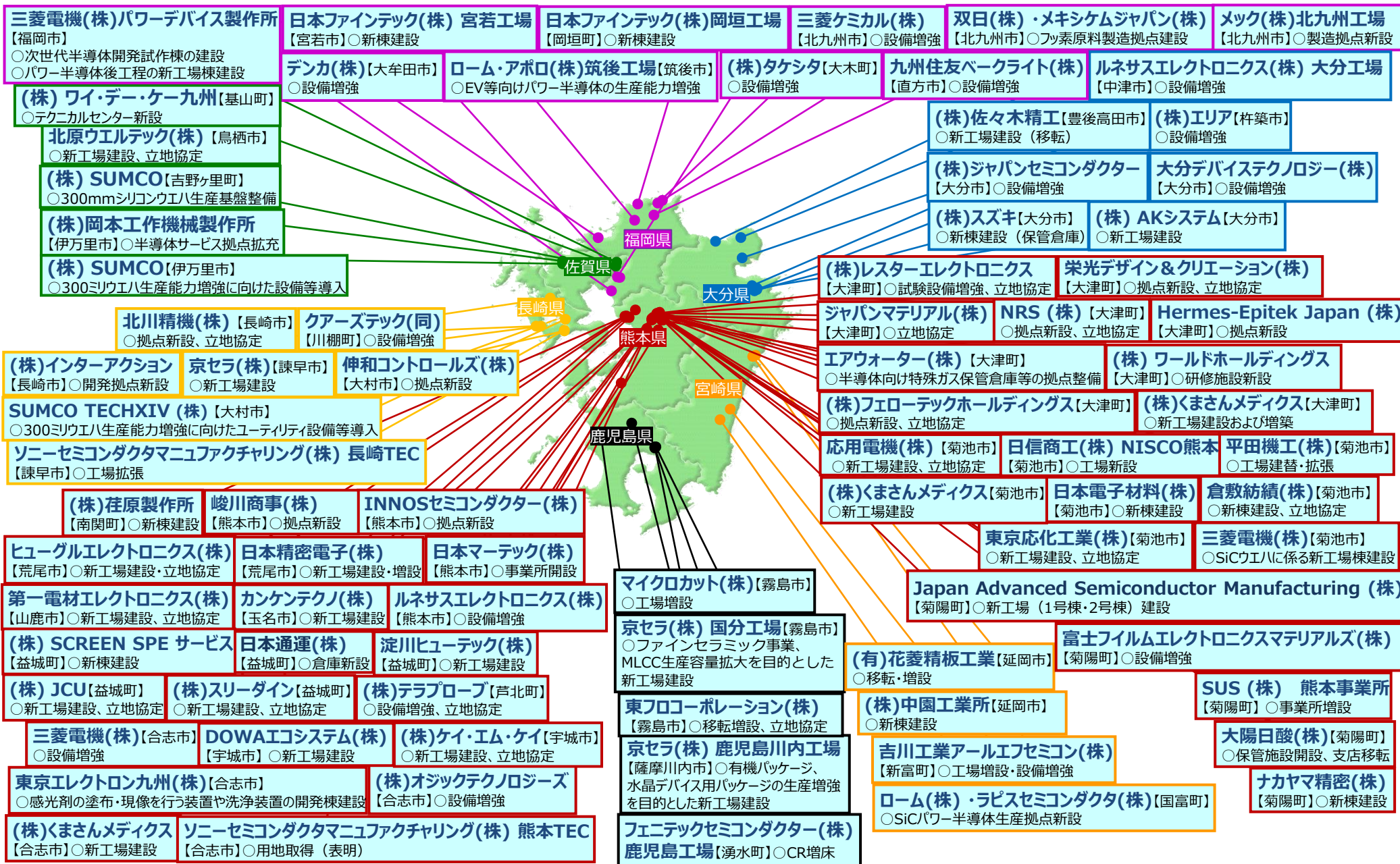


(出所) 九州経済産業局「九州地域の鉱工業動向」
(注) 一定規模以上の全数調査のため、工業統計の数値とは異なる。

九州の半導体産業の動向

企業の主な設備投資計画・立地協定

合計83件、4兆7,000億円超
(金額は公表企業分等の合計額)



半導体産業を巡る動向・トピックス（全国／九州）

		全国の動き	九州の動き
2023年	2Q	・Rapidusへの追加支援(2,700億円)発表(4/25) ・経済安保法に基づく供給計画認定(第1次。ルネサスエレクトロニクス、イビデン)(4/28) ・岸田総理が外資系半導体大手7社首脳と面会(5/18)、G7広島サミット(5/19～21) ・「北海道半導体人材育成協議会」「関東半導体人材育成連絡会議」発足(6/2) ・経済安保法に基づく供給計画認定(第2次。キヤノン、新光電気工業、レゾナックなど8社)(6/16)	・SONYが熊本県合志市で新工場用地を取得する意向を表明(5/25) ・九州大学「価値創造型半導体人材育成センター」開所(6/1)
	3Q	・経済産業省と欧州委員会が半導体に関する協力覚え書きを締結(7/4) ・経済安保法に基づく計画認定(第3次。SUMCO)(7/14) ・Rapidus 新工場起工式(9/1)	・SUMCOが経済安保法に基づく計画承認を受ける(佐賀県伊万里市、吉野ヶ里町)(7/14) ・九州半導体人材育成等コンソーシアム 第3回全体会合(7/26) ・熊本県と北海道が「半導体関連国家プロジェクト推進等に関する連携協定」締結(8/2) ・「福岡半導体リスクリリングセンター」設立(8/23) ・九州FHがJASM進出に伴う経済波及効果を10年間で6兆8,518億円へと上方修正(8/30) ・SIIQ×工業技術研究院(台)がMOU締結(9/7) ・九州大学×陽明交通大学(台)×工業技術研究院(台)がMOU締結(9/7)
	4Q	・産総研が「先端半導体研究センター(略称:SFRC)」を設立(10/1) ・5G促進法に基づく施設整備計画認定(マイクロン)(10/3) ・力晶積成半導体(PSMC)が宮城県での半導体工場設立を発表(10/31) ・令和5年度補正予算成立。半導体関係は全体で1兆9,867億円(既存3基金の残金を含む)(11/29) ・地域産業構造転換インフラ整備推進交付金が措置(11/29) ・経済安保法に基づく供給計画認定(第4次。ローム・東芝デバイス&ストレージ)(12/8) ・ポスト5G基金による次世代半導体パッケージング技術研究拠点への支援が決定(サムスン電子)(12/22)	・「長崎大学マイクロデバイス総合研究センター(CAMRIS)」開所(11/16) ・九州工業大学とSUMCOが包括協力協定(12/7) ・ロームが経済安保法に基づく計画承認を受ける(宮崎県国富町)(12/8) ・熊本県菊陽町が地域産業構造転換インフラ整備推進交付金で採択(12/15) ・「みやざき半導体関連産業人材育成等コンソーシアム」発足(12/19) ・SONY長崎TEC 最終拡張工事(Fab-5)完了(12/22) ・九州経済調査協会が半導体関連設備投資の経済波及効果を10年間で20兆770億円と発表(12/25) ・富士フイルムマテリアルズ熊本工場 先端半導体材料(CMPスラリー)の生産設備導入完了(12/25) ・JASM第1工場が竣工(12月末)
	1Q	・5G促進法に基づく施設整備計画認定(キオクシア、WD)(2/6) ・5G促進法に基づく施設整備計画認定(JASM第2工場)(2月)	・TSMC/JASMが第2工場を熊本県菊陽町に建設すると発表(2/6) ・九州半導体人材育成等コンソーシアム 第4回全体会合(2/27)

2. コンソーシアムでの活動について（2023年度）

- ・高専や工業高校における出前講義**
 - ・教員向け企業研修会**
- ・「九州・台湾半導体技術国際シンポジウム」の開催、MOU署名**

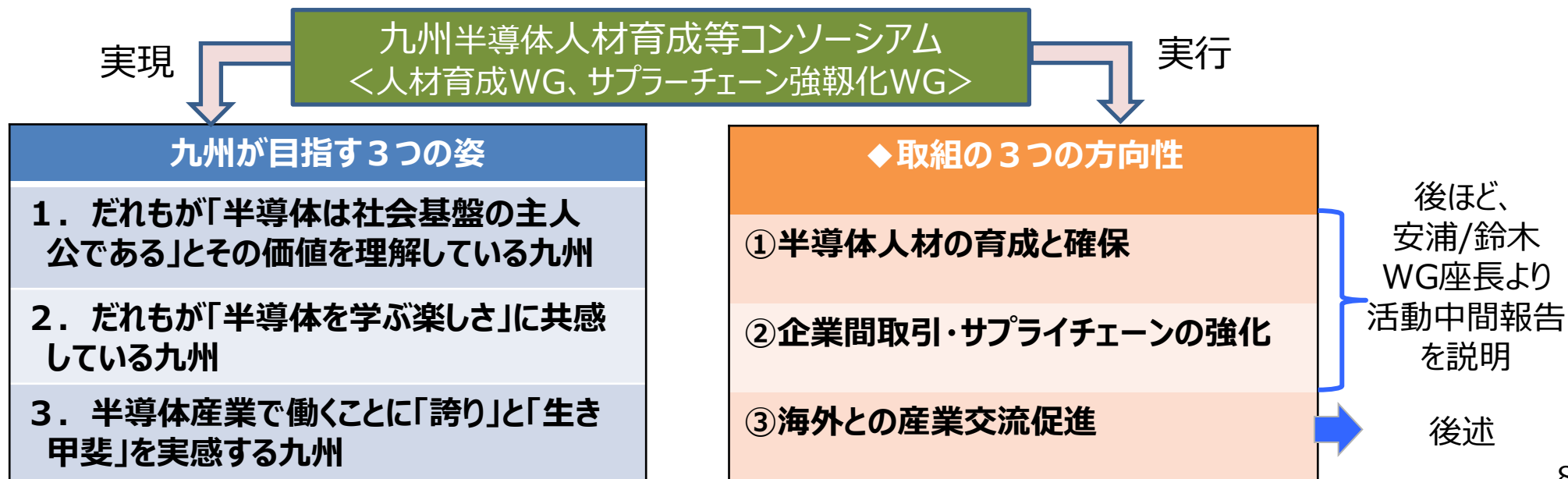
コンソーシアム活動の方向性

1. コンソーシアムの構成について

- ① コンソーシアムは、規約第3条に掲げる趣旨（前条の目的に賛同し、自らが保有する資源の提供等コンソーシアムに協力を惜しまない）に賛同する機関の集合体。
- ② 今後も構成機関による提案・活動、そして、一層の構成機関間の連携等によって、九州が一体となった活動を展開する。
- ③ 今後も、第3条の趣旨に賛同し参画を希望する機関があるときは、規約に基づき、参画の可否を判断する。（＝間口は綴じない）

2. コンソーシアムの活動について

- ・ 九州が目指す3つの姿を実現するため、構成機関が一丸となり、規約第2条に掲げる3つの取組の柱にそった活動を推進する。



産 業 界	1	株式会社アスカインデックス
	2	株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン
	3	株式会社アルプス物流
	4	株式会社ウイルテック
	5	エア・ウォーター株式会社
	6	株式会社エイジェック
	7	エスアイユー株式会社
	8	SMC株式会社
	9	NRS株式会社
	10	株式会社荏原製作所 熊本事業所
	11	株式会社OSナテクノロジー
	12	株式会社オジックテクノロジーズ
	13	株式会社九州日新
	14	株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ
	15	株式会社くまさんメディクス
	16	計測エンジニアリングシステム株式会社
	17	サクセスインターナショナル株式会社
	18	櫻井精技株式会社
	19	株式会社SUMCO
	20	株式会社ジーダット
	21	Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社
	22	株式会社ジャパンセミコンダクター
	23	JSR株式会社
	24	株式会社スズキ
	25	株式会社スタッフサービス
	26	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
	27	株式会社タケシタ
	28	中央電子工業株式会社
	29	株式会社テラプローブ
	30	TXOne Networks Japan合同会社
	31	株式会社デンソー
	32	東京エレクトロン九州株式会社
	33	東京応化工業株式会社
	34	東芝情報システム株式会社
	35	東洋ワーク株式会社
	36	日研トータルソーシング株式会社
	37	日清紡マイクロデバイスAT株式会社
	38	日総工業株式会社
	39	株式会社日本マイクロニクス
	40	株式会社ピーエムティー
	41	株式会社ヒサノ
	42	株式会社藤田ワークス
	43	株式会社マイスティア
	44	株式会社マイナビ
	45	三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所
	46	株式会社安川電機
	47	UTエイム株式会社
	48	吉川工業株式会社
	49	ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場
	50	ラムリサーチ合同会社
	51	リクルーティング・パートナーズ株式会社
	52	ルネサスエレクトロニクス株式会社
	53	株式会社ワールドインテック

教育 機関	54	学校法人岩崎学園
	55	国立大学法人大分大学
	56	国立大学法人鹿児島大学
	57	国立大学法人九州工業大学
	58	国立大学法人九州大学
	59	学校法人近畿大学 産業理工学部（福岡キャンパス）
	60	熊本県立技術短期大学校
	61	国立大学法人熊本大学
	62	独立行政法人国立高等専門学校機構
	63	国立大学法人佐賀大学
	64	崇城大学
	65	東海大学 九州キャンパス
	66	国立大学法人長崎大学
	67	学校法人西日本工業大学
	68	学校法人福岡大学 半導体実装研究所
	69	学校法人福岡工業大学
	70	国立大学法人宮崎大学
	71	福岡県立八女工業高等学校
	72	学校法人早稲田大学 情報生産システム研究センター
行 政 機 関	73	福岡県
	74	佐賀県
	75	長崎県
	76	熊本県
	77	大分県
	78	宮崎県
	79	鹿児島県
	80	北九州市
	81	福岡市
	82	熊本市
	83	文部科学省
	84	経済産業省
	85	国土交通省九州運輸局
	86	国土交通省九州地方整備局
	87	財務省長崎税関
協 力 機 関	88	大分県LSIクラスター形成推進会議
	89	かごしまモノづくり推進協議会
	90	公益財団法人北九州産業学術推進機構
	91	一般財団法人九州オープンイノベーションセンター
	92	公益財団法人九州経済調査協会
	93	一般社団法人九州経済連合会
	94	公益財団法人九州先端科学技術研究所
	95	一般社団法人熊本県工業連合会
	96	公益財団法人佐賀県産業振興機構
	97	国立研究開発法人産業技術総合研究所 九州センター
	98	SEMIジャパン
	99	独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部
	100	一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
	101	株式会社日本政策投資銀行
	102	独立行政法人日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター
	103	公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団
	104	明倫国際法律事務所
事 務 局		経済産業省九州経済産業局
		一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会

※太字は当初メンバー。区分毎に五十音順（行政機関除く）
※赤字は2023年7月19日以降に追加された構成機関。

新規構成機関（ご紹介）

■九州半導体人材育成等コンソーシアムは、104機関の産・学・官で構成。 ※2024年2月27日時点

■新規に参画した構成機関は以下のとおり。

期日	産学官	構成機関名	所在地	業種等	参加WG
7月19日	産業界	吉川工業株式会社	福岡県	鉄鋼・エレクトロニクス	人材・S C
9月5日	教育機関	福岡県立八女工業高等学校	福岡県	工業高校	人材
10月3日	産業界	株式会社ヒサノ	熊本県	運輸・物流	SC
10月17日	産業界	株式会社アルプス物流	神奈川県	運輸・物流	人材・S C
10月18日	産業界	東洋ワーク株式会社	宮城県	人材	人材
10月18日	産業界	株式会社ウイルテック	大阪府	人材	人材
11月7日	産業界	株式会社荏原製作所 熊本事業所	熊本県	製造装置	SC
11月20日	産業界	ラムリサーチ合同会社	神奈川県	製造装置	人材・S C
24年1月9日	行政機関	長崎税関	長崎県	官公庁	SC
1月12日	産業界	株式会社九州日新	福岡県	運輸・物流	SC
1月16日	産業界	TXOne Networks Japan合同会社	東京都	情報セキュリティ	SC
1月16日	教育機関	学校法人福岡工業大学	福岡県	大学・大学院	人材
2月13日	教育機関	学校法人西日本工業大学	福岡県	大学・大学院	人材・S C
2月14日	産業界	株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ	東京都	運輸・物流	SC
2月15日	行政機関	国土交通省九州地方整備局	福岡県	官公庁	人材・S C

コンソーシアムと2つのワーキンググループ

- コンソーシアムの取組は、全体会合において構成機関間で共有と意識の統一を行う。
- 取組の具体化と実行は、コンソーシアムの下に設置する2つのワーキンググループ（WG）において行う。WGには、構成機関や有識者等が参加し、事務局はSIIQが担う。

※全体推進



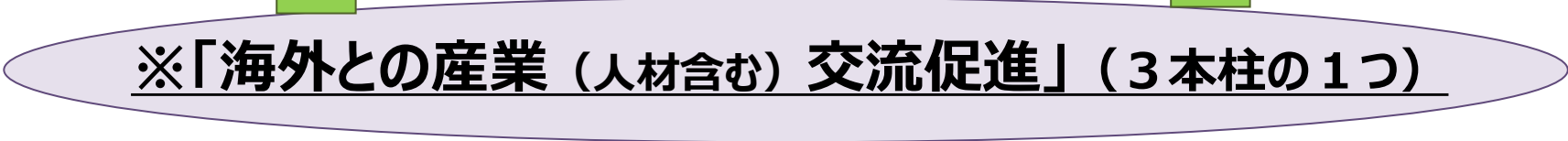
※2022年3月29日設立。
※九経局が会合開催等の事務を担う

※具体的活動の推進（2つのWG）

※2つのWGは、2022年5月18日設置。
※SIIQがWGの事務局を務める。



※2つのWGの活動に含まれる



3つの方向性

- 半導体人材の育成・確保（⇒人材育成WG）
- 半導体大手企業と地場企業、ユーザー企業との取引強化（⇒サプライチェーン強靱化WG）
- 海外との産業交流促進（⇒「九州・台湾半導体交流訪問団」のフォロー、新展開）

1. 半導体人材の育成・確保

①半導体産業の魅力発信

【現状】

- ・理系学生等への認知が不十分で、半導体、半導体産業の魅力が浸透していない

例）半導体産業に「関心がある」学生等は、半数程度（51%）
「半導体産業で働きたいと思わない」が6割超（61.4%）

【活動内容】

- ・半導体人材裾野拡大に向けたコンテンツの検討・試作
- ・教員向け企業研修会の実施 等

②人材育成・確保

【現状】

- ・高専での育成、大学等での社会人育成、出前授業が各地で始動。複数の大学等で次年度から人材育成体制が強化
- ・九州では、1,000人程度の人材不足が続く見通し
- ・グローバルレベルの人材育成について有識者による議論開始
- ・台湾では、企業が大学等に資金・人材を投入。共同研究や即戦力人材の育成につなげている（⇒3. 海外・・・へ）

【活動内容】

- ・半導体人材受給ギャップ、教育・輩出ポテンシャル【調査】
- ・汎用的・横断的な学習コンテンツの検討・試作
- ・大学連携によるプロフェッショナル・グローバル人材育成の検討

2. 半導体大手企業と地場企業等との取引強化

③サプライチェーン強靱化

【現状】

- ・設備投資・新規立地が活性化。九州のプレゼンスが向上
- ・企業間取引では、ロックダウン等による稼働停止を受け、サプライチェーンが混乱。企業間ネットワーク強化の必要性を確認

【活動内容】

- ・顔の見えるネットワーク構築に向けた「連携の深化と拡大」
- ・設計・開発力強化などの「新たなビジネスモデル」検討WS開催
- ・脱炭素などグローバルサプライチェーンで必要となる勉強会開催 等

3. 海外との産業交流促進

④台湾との産学交流促進

【現状】

- ・「九州・台湾半導体交流訪問団」の訪台を機に、現地及び当地サプライチェーン参入への期待が上昇
- ・現地大学等への訪問を機に、大学間で交流拡大の機運が萌芽

【活動内容】

- ・SEMICON Taiwan（9月）での訪台
（九州・台湾半導体技術・人材交流国際シンポジウム/現地調査）
- ・台湾EXPO（11月）での訪日団受入れ 等

コンソーシアムでの主な取組事例

※SIIQ：（一社）九州半導体・デジタルイノベーション協議会

1. 高専や工業高校等における出前講義（拡充）

- **佐世保高専**によるボリュームゾーン人材向けの講座として、SIIQ[※]コーディネーターが講師となり、**2022年度に引き続き、前期に「半導体工学概論」、後期に「半導体デバイス工学」**の出前講義を実施。約90名の学生が参加。
- また、前年度の課題を踏まえつつ、佐世保高専で実施した講義のオンデマンド方式を活用した**熊本高専**での「半導体工学概論」及び、**熊本工業高校**で「半導体人材育成授業（全3回）」（約200名）を実施。
- さらに**2024年度は、上記の取組を大分大学に横展開**したほか、**地域企業や支援機関等が講師として参画する同様の取組を北九州高専、大分高専においても実施。**

2023年度佐世保高専における半導体出前講義カリキュラム

前期：半導体工学概論（4月11日～8月1日 実施済）

科目名	半導体工学概論（選択科目／履修単位／1単位）90分授業		
開講時期	前期	対象学年・学科	4年生・全学科 他高専からオンデマンドで視聴
シラバス・講師	回	内容	講師
	1	ガイダンス	佐世保高専
	2	半導体の歴史	佐世保高専
	3	結晶構造とバンド構造、半導体の分類とキャリア	佐世保高専
	4	ディスクリート（ダイオード、トランジスタ）	SIIQ
	5	集積回路（マイコン）	SIIQ
	6	メモリー素子	SIIQ
	7	光学素子（半導体レーザーなど）	SIIQ
	8	パワー半導体（パワーエレクトロニクス）	SIIQ
	9	CMOSセンサー	SIIQ
	10	実地見学：ソニーセミコンダクタソリューションズ	同左
	11	半導体製造技術Ⅰ：設計	九工大
	12	半導体製造技術Ⅱ：前工程	九工大
	13	半導体製造技術Ⅲ：後工程	九工大
	14	実地見学：日清紡マイクロデバイスAT	同左
	15	半導体の最新動向	佐世保高専

全
学
科

産
学
に
よ
る
出
前
授
業
（
15
回
中
9
回
）

見
施
学
設

受講生の満足度（SIIQ講師分）：90.7%

受講生
の
声

- ・専門家の方のお話を聞けることは貴重なので、とても良かった。**実用例はとても興味深かった**ので続けて欲しい。
- ・電子の動きがとてもわかりやすく、**トランジスタの役割や仕組みがよくわかった**。日本でも**集積回路を作っている会社が多いと知ってびっくりした**。
- ・学生への問いかけや先生の経験を例に話しているのでわかりやすかった。半導体を用いることで**人々の暮らしは大変便利になる**ことがわかった。

後期：半導体デバイス工学（10月10日～2月6日 実施済）

科目名	半導体デバイス工学（選択科目／履修単位／1単位）90分授業		
開講時期	後期	対象学年・学科	4年生・全学科 他高専からオンデマンドで視聴
シラバス・講師	回	内容	講師
	1	半導体デバイスの製造概論	インテル
	2	半導体製造：前工程①半導体材料（シリコンウエハ）	SUMCO
	3	半導体製造：前工程②トランジスタの形成	SIIQ
	4	半導体製造：前工程③配線工程など	SIIQ
	5	半導体製造：集積化技術	SIIQ
	6	半導体製造：後工程①ダイシング・ダイボンド	SIIQ
	7	半導体製造：後工程②封止・特性検査・信頼性試験	SIIQ
	8	品質管理と信頼性技術	ルネサスエレクトロニクス
	9	半導体製造における設計	日清紡マイクロデバイスAT
	10	洗浄技術とその評価	SCREEN-SS
	11	半導体製造におけるクリーン化技術	産業技術総合研究所
	12	実験実習：半導体材料検討・開発プロセス	佐世保高専
	13	半導体製造および研究分野の調査Ⅰ	佐世保高専
	14	半導体製造および研究分野の調査Ⅱ	佐世保高専
	15	半導体製造および研究分野の調査Ⅲ	佐世保高専

全
学
科

産
学
に
よ
る
出
前
授
業
（
15
回
中
11
回
）

受講生の満足度（SIIQ講師分）：93.4%

コンソーシアムでの主な取組事例

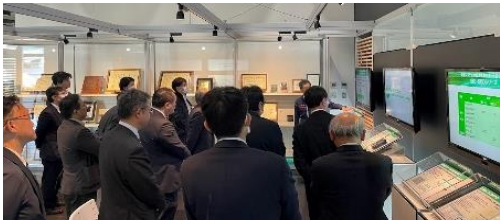
2. 教員向け企業研修会（拡充）

- **大学や高専等の教員を対象**に、産業界の協力を得て、半導体の用途や製造現場を見学・実感する機会を提供。
 - 内容は、半導体企業の**現場見学**、人事担当者・社員（参加者所属校の卒業生）との**座談会**など。
 - 2023年度は、前年度の実施結果を踏まえ「**入門編**」「**中級編**」の**2コースを設定**。参加する教員の理解度に応じた見学コース、対応者・説明内容を用意して理解向上を目指した。（5社で実施。参加67名。前年度比7名増）
 - 開催後のアンケートでは、「非常に役立った＋役立った」の**評価合計が97%**。
- 【参加者からの主な意見】
- ・ WEBやパンフレットにはない人材採用情報があつたため、**生徒の就職活動・進路指導などに役立てていきたい**。
 - ・ 実際の**現場の雰囲気を見る**ことができたこと、**半導体製造装置の使い方やクリーンルームの見学**ができたことが良い経験になった。
 - ・ **若手社員の考え方や本音を直接聞いたこと、参加した教員の方も含めて多方面の意見**を聞いて参考になった。

No.	実施企業	実施場所	主な事業内容	対象		実施日	申込状況
				入門編	中級編		
1	三菱電機パワーデバイス製作所	福岡市西区今宿東1-1-1	組立・テスト	○		2023年12月8日	・大学：8名 ・高専：2名 ・高校：4名 計：14名
2	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング	諫早市津久葉町1883-43	画像センサー製造		○	2023年12月12日	・大学：4名 ・高専：4名 ・高校：9名 計：17名
3	SUMCO	伊万里市山代町久原1-52	ウエハ製造		○	2023年12月22日	・大学：4名 ・高専：4名 ・高校：5名 計：13名
4	日清紡マイクロデバイスAT	神埼郡吉野ヶ里町立野950	組立・テスト	○		2024年1月16日	・大学：3名 ・高専：3名 ・高校：12名 計：18名
5	アスカインデックス	水俣市丸島町3-5-1	ウエハ		○	2024年1月24日	・大学：3名 ・高専：1名 ・高校：1名 計：5名

※対象区分 入門編：半導体を専門とされていない進路指導担当などの皆様
中級編：半導体を専門として評価・研究等をされている皆様

合計：67名



三菱電機パワーデバイス製作所訪問



ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング訪問



日清紡マイクロデバイスAT訪問



SUMCO訪問



アスカインデックス訪問

コンソーシアムでの主な取組事例

3. 海外との産業交流促進（SEMICON台湾での国際シンポジウム開催、MOU締結）

- 2023年2月、九州と台湾の半導体産業の活性化を目的に、「九州半導体人材育成等コンソーシアム」主要メンバーによる訪台団を派遣（28機関41名）。九州及び台湾の双方における交流の機運が醸成された。
- 今回、そのフォローアップを目的に、「セミコン台湾2023」期間中に、双方の産学官による「九州・台湾半導体技術国際シンポジウム」を現地で開催（100名参加）。「SIIQ×工業技術研究院（ITRI・台）」、「九州大学×陽明交通大学（台）×工業技術研究院」によるMOUに署名するとともに、以下の調査を実施。
 - 人材育成に係る現地調査（陽明交通大学、TSMC（大学・高校向け人材育成プログラム））
 - サプライチェーンに係る現地調査（セミコン台湾2023、現地日系企業へのヒアリング）

1. 日程：2023年9月6日（水）～9月9日（土）
2. 主なメンバー：
九州半導体人材育成等コンソーシアム（岩上代表幹事、事務局）
（一社）九州半導体・デジタルイノベーション協議会（山口会長、事務局）
九州大学（白谷副学長、金谷教授、井上教授）

3. 訪問先：

①台北市

日本台湾交流協会 台北事務所
セミコン台湾2023（来場6.2万人/出展950社・3000ブース/25国際フォーラム）
台塑勝高科技股份有限公司（Formosa SUMCO Technology）

②新竹市

陽明交通大学（NYCU）／ 台湾積体電路製造（TSMC）

SEMICON® TAIWAN

Sep. 6-8, 2023, TaiNEX 1&2, Taipei

MOU署名



SIQ（山口会長）×ITRI（林所長）

九州・台湾間またはSIIQ・ITRI間における、半導体・電子・デジタル産業に関わる技術情報の相互提供 等



九大（白谷副学長）×
ITRI（胡副院長）×陽明交通大（林学長）

研究者間の技術連携及び人材交流の促進（対象分野は「半導体、スマートビークル（スマートモビリティ）、グリーンエネルギー」）



陽明交通大学（2023年9月8日）



TSMC（2023年9月8日）



半導体国際シンポジウム（2023年9月7日）



3. コンソーシアムでの活動について（2023年度）

- ・人材育成WG
- ・サプライチェーン強靱化WG

半導体人材の育成・確保（人材育成WG）

2022年度の主な活動

※「⇒」において、活動を通じて判明した課題、調査結果を記載

- 高専や工業高校における出前講義（SIIQ、佐世保高専・熊本高専・熊本工業高校等）
⇒ 各高専への横展開や講師の不足。教材の更新・汎用化。
- 大学・高専等の教員向け企業研修会（SIIQ、半導体企業、九州工業大学）
- 調査事業（企業の採用計画、学生・大学等への意識調査）
⇒ 九州では向こう10年間、1,000人/年程度の人材不足が続く見通し。
⇒ 半導体産業の魅力が浸透していない（61.4%の学生が「働きたいと思わない」）。

2023年度の主な活動

- ① 半導体人材の育成・裾野拡大（理工系人材）
 - ・ 高専等の出前講義・教員向け企業研究会の継続実施、横展開。
 - ・ 理論と実践を学べる“横断的学習コンテンツ”の試作・評価
 - ・ 産学・学学連携による“グローバル・プロフェッショナル人材（トップ人材）”の育成。
- ② 半導体産業の魅力発信
 - ・ 若年層（小・中学生）や保護者を対象とした“魅力発信コンテンツ”の試作・評価。
- ③ 調査事業（教育機関などの人材輩出側への調査）
 - ・ 理工系高校・大学の定員・教員・施設や卒業後の進路から人材教育・輩出力を調査。
 - ・ 2022年度調査結果との比較による、半導体人材の“需給ギャップ”の明確化。

大手企業と地場企業等との取引強化（サプライチェーン強靱化WG）

2022年度の主な活動

※「⇒」において、調査結果を記載

● 調査事業（WGメンバー及びSIIQ会員企業への現況調査、ニーズ調査）

- ⇒ 各社とも、コロナ禍によるサプライチェーン混乱と原材料コスト高騰の影響を受け、非常時のリスクヘッジとして「九州域内の関係強化」「九州域外との連携拡大」の必要性を感じている。
- ⇒ サプライチェーン参入の契機として想定する技術課題としては、「三次元実装」、「ウエハ大口径化への対応」、「設計・開発力の強化」等。ただし、いずれの課題も自社単独での対応は困難として、「産・産連携」や「産学官連携」による技術開発が重要との声が多数。
- ⇒ 災害など非常時のBCPの必要性については理解するが、営業情報の社外開示への懸念あり。

2023年度の主な活動

① 企業間連携の深化（域内）と拡大（域外）

- ・ 域内の連携強化を目的とした「ワークショップ（テーマ：BCP/物資安定供給）」の実施。SIIQ会員との「企業間交流会」の開催。
- ・ 九州域外企業との連携・マッチング支援（東北地域：レガシー製造装置のパフォーマンス維持、中国地域：デバイスメーカー・サプライヤーとのマッチング）。

② 新たなビジネスモデル構築支援

- ・ 九州の半導体産業の活性化に向けた“バリューチェーン構築”を目的としたWS実施。

③ グローバルサプライチェーンへの対応支援

- ・ カーボンニュートラル、サイバーセキュリティに焦点を当てたセミナーや勉強会の開催。

2023年度 活動スケジュール

	2023年			2024年
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
全体会合		● 第3回会合 (7/26)		● 第4回会合 (2/27)
人材育成WG		● 第1回WG (8/7) NEDO調査事業 (7/20採択) サブWG（横断的学習） ●第1回（8/31） サブWG（教育・輩出力） ●第1回（8/30） ●準備会合第1回（4/7） ●準備会合第2回（6/29） ●台湾調査 ●第1回（10/10） ☆インタビュー ●第2回（1/10）	● 第2回WG (11/8) ●第2回（11/27） ●第2回（11/20） ●第1回（10/10） ☆インタビュー ●第2回（1/10）	● 第3回WG (2/14) ●第3回（1/26） ●第3回（1/26） ●第2回（1/10）
サプライチェーン強靱化WG		● 第1回WG (8/8) 知財事業（採択済）	● 第2回WG (11/17) BCP連携モデルWS ●第1回（11/9） ●●第2・3回（12/8、20） バリューチェーン構築WS ●●第1・2回（1/17、23） ●知財セミナー（10/13） ●セキュリティセミナー（1/15）	● 第3回WG (2/15)
【参考】 ・出前講座 ・教員向け研修会 ・海外交流事業	佐世保高専、SIIQ、九工大 北九州高専、FAIS（4/28）	熊本工業高校、SIIQ 木更津高専、SIIQ 高校、大学、一般向け講座 FAIS セミコン台湾・シンポジウム（9/6～8）	佐世保高専、SIIQ 熊本高専、SIIQ 大分大、SIIQ、大分県 教員向け企業研修会（SIIQ、構成機関） 福岡大学・理学部、SIIQ（12/15）	熊本工業高校、SIIQ

3. 規約改正について

規約改正について

改正内容

- 幹事の任期について、任命の日から1年とする。（補足：現時点で幹事は未設置）
- 構成機関を新たに15機関追加したことによる「別紙 九州半導体人材育成等コンソーシアム構成機関一覧（令和5年7月26日現在）」の改正

改正後	現行
（構成） 第3条 コンソーシアムは、前条の目的に賛同し、自らが保有する資源の提供等コンソーシアムに協力を惜しまない半導体関連企業、関係団体、支援機関、教育機関、国の行政機関並びに関係地方公共団体等の別表に掲げる機関によって構成する。 2 コンソーシアムに幹事を置く 一、経済産業省九州経済産業局長及び一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会会長が指名した者が共同でコンソーシアムを代表する幹事（以下「代表幹事」という。）を務めるものとする。 二、代表幹事は、コンソーシアムの目的に照らし参画が適切でないと認められる場合を除き、構成機関を追加することができる。 三、代表幹事は、必要と認めるときは、幹事を追加することができる。 四、幹事の任期は、<u>任命の日から一年</u>とする。ただし、再任することができる。	（構成） 第3条 コンソーシアムは、前条の目的に賛同し、自らが保有する資源の提供等コンソーシアムに協力を惜しまない半導体関連企業、関係団体、支援機関、教育機関、国の行政機関並びに関係地方公共団体等の別表に掲げる機関によって構成する。 2 コンソーシアムに幹事を置く 一、経済産業省九州経済産業局長及び一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会会長が指名した者が共同でコンソーシアムを代表する幹事（以下「代表幹事」という。）を務めるものとする。 二、代表幹事は、コンソーシアムの目的に照らし参画が適切でないと認められる場合を除き、構成機関を追加することができる。 三、代表幹事は、必要と認めるときは、幹事を追加することができる。 四、幹事の任期は、<u>令和6年3月31日まで</u>とする。ただし、再任することができる。
附則 1 この規則は、令和5年7月26日から施行する。 <u>附則</u> <u>1 この規則は、令和6年2月27日から施行する。</u>	附則 1 この規則は、令和5年7月26日から施行する。

産 業 界	1	株式会社アスカインデックス
	2	株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン
	3	株式会社アルプス物流
	4	株式会社ウイルテック
	5	エア・ウォーター株式会社
	6	株式会社エイジェック
	7	エスアイユー株式会社
	8	SMC株式会社
	9	NRS株式会社
	10	株式会社荏原製作所 熊本事業所
	11	株式会社OSナテクノロジー
	12	株式会社オジックテクノロジーズ
	13	株式会社九州日新
	14	株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ
	15	株式会社くまさんメディクス
	16	計測エンジニアリングシステム株式会社
	17	サクセスインターナショナル株式会社
	18	櫻井精技株式会社
	19	株式会社SUMCO
	20	株式会社ジーダット
	21	Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社
	22	株式会社ジャパンセミコンダクター
	23	JSR株式会社
	24	株式会社スズキ
	25	株式会社スタッフサービス
	26	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
	27	株式会社タケシタ
	28	中央電子工業株式会社
	29	株式会社テラプローブ
	30	TXOne Networks Japan合同会社
	31	株式会社デンソー
	32	東京エレクトロン九州株式会社
	33	東京応化工業株式会社
	34	東芝情報システム株式会社
	35	東洋ワーク株式会社
	36	日研トータルソーシング株式会社
	37	日清紡マイクロデバイスAT株式会社
	38	日総工業株式会社
	39	株式会社日本マイクロニクス
	40	株式会社ピーエムティー
	41	株式会社ヒサノ
	42	株式会社藤田ワークス
	43	株式会社マイスティア
	44	株式会社マイナビ
	45	三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所
	46	株式会社安川電機
	47	UTエイム株式会社
	48	吉川工業株式会社
	49	ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場
	50	ラムリサーチ合同会社
	51	リクルーティング・パートナーズ株式会社
	52	ルネサスエレクトロニクス株式会社
	53	株式会社ワールドインテック

教育 機関	54	学校法人岩崎学園
	55	国立大学法人大分大学
	56	国立大学法人鹿児島大学
	57	国立大学法人九州工業大学
	58	国立大学法人九州大学
	59	学校法人近畿大学 産業理工学部（福岡キャンパス）
	60	熊本県立技術短期大学校
	61	国立大学法人熊本大学
	62	独立行政法人国立高等専門学校機構
	63	国立大学法人佐賀大学
	64	崇城大学
	65	東海大学 九州キャンパス
	66	国立大学法人長崎大学
	67	学校法人西日本工業大学
	68	学校法人福岡大学 半導体実装研究所
	69	学校法人福岡工業大学
	70	国立大学法人宮崎大学
	71	福岡県立八女工業高等学校
	72	学校法人早稲田大学 情報生産システム研究センター
行 政 機 関	73	福岡県
	74	佐賀県
	75	長崎県
	76	熊本県
	77	大分県
	78	宮崎県
	79	鹿児島県
	80	北九州市
	81	福岡市
	82	熊本市
	83	文部科学省
	84	経済産業省
	85	国土交通省九州運輸局
	86	国土交通省九州地方整備局
	87	財務省長崎税関
協 力 機 関	88	大分県LSIクラスター形成推進会議
	89	かごしまモノづくり推進協議会
	90	公益財団法人北九州産業学術推進機構
	91	一般財団法人九州オープンイノベーションセンター
	92	公益財団法人九州経済調査協会
	93	一般社団法人九州経済連合会
	94	公益財団法人九州先端科学技術研究所
	95	一般社団法人熊本県工業連合会
	96	公益財団法人佐賀県産業振興機構
	97	国立研究開発法人産業技術総合研究所 九州センター
	98	SEMIジャパン
	99	独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部
	100	一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
	101	株式会社日本政策投資銀行
	102	独立行政法人日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター
	103	公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団
	104	明倫国際法律事務所
事 務 局		経済産業省九州経済産業局
		一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会

※太字は当初メンバー。区分毎に五十音順（行政機関除く）
※赤字は2023年7月19日以降に追加された構成機関。